



TIF® 100L 2050-06 是一款超低硅氧挥发的导热垫片，专为光学与高精密应用设计。其柔软弹性的材料可填补发热元件与散热片或金属底座之间的不平整空隙，提升热传导效率，有效延长电子组件寿命。陶瓷填充的硅胶结构不仅具备良好的导热性能，更具有极低的低分子硅氧烷挥发性，能大幅降低光学装置内部污染风险。

## 特性

- 》超低硅氧烷挥发
- 》良好的热传导率
- 》带自粘而无需外表面粘合剂
- 》高可压缩性，易于安装操作
- 》良好的绝缘性能

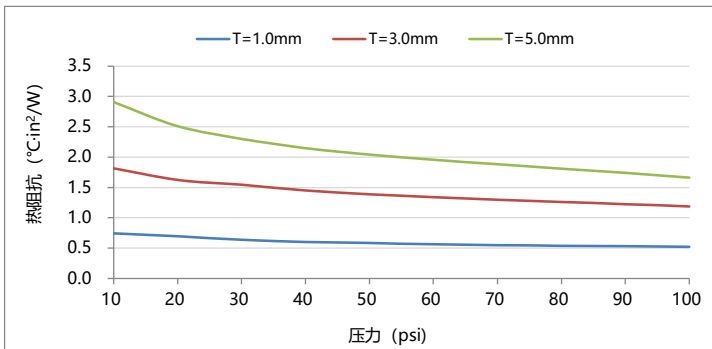
## 应用

- 》嵌入式主板
- 》工业视觉检测设备
- 》显卡散热模组
- 》充电桩功率模块
- 》中控屏

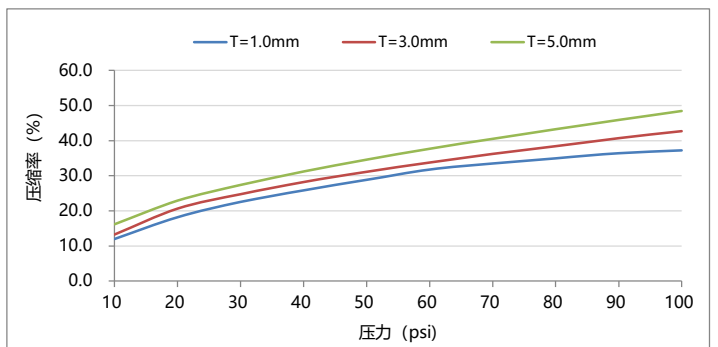
### TIF® 100L 2050-06 系列特性表

产品特性	典型值		测试方法
颜色	白色		目测
结构&成份	陶瓷填充硅橡胶		-
厚度范围 (inch/mm)	0.010~0.020 0.25~0.50	0.030~0.200 0.75~5.00	ASTM D374
硬度 (Shore OO)	65	50	ASTM D2240
密度 (g/cm <sup>3</sup> )	2.9		ASTM D792
建议使用温度范围 (°C)	-40 ~ 200		-
击穿电压 (V/mm)	≥5500		ASTM D149
介电常数 @1MHz	7.0		ASTM D150
体积电阻率 (Ohm-cm)	> 1.0×10 <sup>12</sup>		ASTM D257
导热系数 (W/m·K)	2.0		ASTM D5470
	2.0		ISO22007
∑D3-D10 (PPM)	< 100		GC-MS
阻燃等级	V-0		UL94 (E331100)

### 热阻抗



### 压缩率



## 产品规格

标准厚度: 0.010" (0.25 mm) ~ 0.200" (5.00 mm), 以 0.010" (0.25 mm) 为增量。

标准尺寸: 16"×16" (406 mm×406 mm)

TIF®系列可模切成不同形状提供。如需不同厚度或想了解更多导热材料的产品信息，请与本公司联系

## 产品型号说明

TIF1 00 L 2050 - 06

- 颜色: 06 (白色)
- 导热系数: 2.0 W/m·K & 硬度: 50
- 低挥发
- 厚度: 10 mils~200 mils
- 产品系列

## 全球方案: 在地服务

中国: +86-769-38801208  
台湾: +886-2-2277-1007  
加拿大: +001-604-2998559  
越南: +84-396852859

service@ziitek.com

www.ziitek.com

Ziitek Technology Ltd (兆科技术有限公司) 及其代理商提供的信息被认为是准确和可靠的，产品规格可能因技术改动或优化而调整，恕不另行通知。产品的使用和应用责任由最终用户承担，Ziitek (兆科) 本公司不对产品的适用性、可销售性或特定用途任何保证，亦不承担任何附带或间接损害的责任。Ziitek (兆科) 及其标志为公司或关联公司所有。



TIF100L 2050-06-0426